

## **陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司根据项目实施的实际情况做出部分募投项目延期的决定，具体情况如下：

### **一、 募集资金基本情况**

2022年11月1日，中国证监会出具《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2638号），批准公司首次公开发行股票注册的申请，公司首次公开发行的股份数量为1,500万股。2022年12月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA16225号），经审验，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1元，发行价格100.66元/股，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币131,222,672.46元，实际募集资金净额为人民币1,378,677,327.54元。公司首次公开发行募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

### **二、 募投项目基本情况**

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 12 月 31 日募集资金累计投入	截止 2023 年 12 月 31 日投入进度 (%)
1	10G、25G 光芯片产线建设项目	57,000.00	38,585.22	67.69
2	50G 光芯片产业化建设项目	12,000.00	3,398.05	28.32
3	研发中心建设项目	14,000.00	2,374.31	16.96
4	补充流动资金	15,000.00	14,295.86	95.31
	合计	98,000.00	58,653.44	

注：上述募集资金累计投入包含 2023 年 1 月 12 日经董事会审议通过使用募集资金置换预先前期以自有资金投入的金额。

### 三、 本次募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

#### (一) 本次部分募投项目延期情况

根据公司生产经营开展情况，结合目前公司的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将前述项目达到预定可使用状态的时间进行调整如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	10G、25G 光芯片产线建设项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月
2	50G 光芯片产业化建设项目	2024 年 12 月	2025 年 12 月
3	研发中心建设项目	2024 年 12 月	2026 年 12 月

#### (二) 本次部分募投项目延期原因

##### 1、公司坚持市场需求和投资支出相适应的原则，实施分步建设的产能投资安排，以提高资金使用效率并更好地适应市场需求

截至目前，公司的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施投入已完成，从硬件设施方面可保障后期产能的快速导入。在产能项目投资方面，公司率先安排“10G、25G 光芯片产线建设项目”的建设投资，并在生产线设计方面进行通用性设计，兼容 50G 等高速率光芯片的生产标准要求；随后公司根据市场和经营需求情况，进行“50G 光芯片产业化建设项目”的建设。

2023 年度，光芯片市场和主要客户需求均低于预期，同时光芯片产品迭代速度加快，产品成本竞争压力有所加剧。因此，对于上述两个项目，公司的资本性投资进度和新增产能导入速度有所放缓；同时，公司进一步优化生产线设计，

以更好地适应市场需求。

**2、公司坚持 IDM 生产模式，为满足市场多样化需求及有效应对成本竞争，公司坚持“柔性、兼容”的产线设计原则，同时导入 3 寸晶圆的生产工艺，导致设备投入和调试周期有所拉长**

为满足市场需求，公司的产品类型从 DFB 产品逐步转移为涵盖 DFB、EML 等多种类型的光芯片，产品速率也从 2.5G、10G 等中低速率逐步延伸至 25G、50G、100G 等高速率产品。此外，公司坚持 IDM 生产模式，在新增晶圆生产线设计方面，由原有 2 寸晶圆生产线调整至同时兼容 2 寸和 3 寸晶圆生产的工艺设计安排，以提升晶圆的生产效率，更好地应对市场成本竞争。基于上述工艺安排，公司设备投入和调试周期有所拉长。

**3、在保障持续加大研发投入的前提下，公司采取分步建设的基础设施建设方案，稳步推进研发中心建设项目等硬件投入**

公司在基础设施建设内容采用分步建设的策略，其中，对于厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施隶属于产业化类投资项目，公司将其作为一期基础设施建设项目率先进行投资。研发大楼隶属于研发中心建设项目，公司则将其作为二期基础设施建设项目。

截至目前，公司的厂房、宿舍楼、超净室车间、污水处理系统等基础性设施已投入使用，其能够满足产能导入的硬件设施需求，同时能够支持现有研发工作的正常开展。后续，公司将在确保研发工作正常进行的情况下，逐步推进研发中心建设项目等硬件投入，以保障公司业务的稳步发展。

#### **四、 本次募投项目延期对公司的影响**

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

#### **五、 履行的审议程序**

2024年4月24日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

## 六、 专项意见说明

### （一）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实施情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质上的影响，不存在改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

### （二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

源杰科技本次部分募投项目延期是基于部分募投项目实际情况做出的决定，本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东的情形。

保荐机构对源杰科技本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2024年4月26日